

前瞻性晶片製作申請及審查流程

修訂日期: 2021.12.27

- 前瞻性申請處理時間從截止日(星期一)起至下線約需 5 週
- 以下對時間之描述是以申請截止日當週稱為第 1 週

Step 1. 申請晶片製作前之準備 (申請者準備)

1. 從 TSRI 網站下載並詳讀申請需知與說明
2. 確認指導教授及申請者已在 TSRI 網站加入會員
3. 確認指導教授已申請該製程並授權申請者使用
4. 確認指導教授已繳交智慧財產權切結書
5. 確認技術檔案(DRC, LVS)版本是否和 TSRI 網站公佈內容相同
6. Layout 完成且已依 Tape out review form 通過驗證並符合可允許之 DRC 錯誤狀況
7. 檢查是否有缺交測試報告

Step 2. 申請晶片製作 (申請者準備)

1. 至下線申請網頁填寫申請表
2. 利用下線申請網頁上傳技術資料
3. 利用下線申請網頁上傳設計內容電子檔與 Tape Out Review Form (請使用 WORD 格式)
4. 至下線申請網頁確認 GDS 檔案是否正確

附註:

- 逾時申請者不受理該申請案
- 申請日截止後不再接受申請案之更新

Step 3. 申請案資料審核與建檔 (TSRI 處理, 於第 1 週星期五前完成)

1. 檢查上傳之電子檔是否齊全
2. 檢查設計內容是否撰寫完整 (未包含規定之章節者視為內容不完整)
3. 檢查 Tape out review form 內容是否正確
4. 檢查設計內容佈局圖與 GDS 檔案是否相符
5. 再做 DRC 驗證以確保佈局檔符合晶圓廠製造規範
6. 網站公佈並 email 申請者資料 (包含受理與不受理名單)

附註:

- 未符合 Design Rule 或可允許之假錯時, 直接列入不受理

Step 4. 安排下線晶片 TSRI 處理, 第 2 ~ 5 週)

1. 進行晶片審查作業 (包含書面審查與審查會審查)
2. 網站公佈並 email 審查結果報告 (申請者需根據委員意見進行回覆)
3. 依教授的評比與 Total Credit 分數排序依序排入下線, 直至可用面積用盡為止
4. 網站公佈並 email 申請者下線晶片資料 (包含無法下線名單)
5. 上傳至晶圓廠製作 IC

Step 5. 晶片量測及撰寫測試報告 (申請者準備)

1. 晶片製作完成後以郵寄方式寄給指導教授
2. 申請者於收到晶片後需在 2 個月內繳交測試報告
3. 報告內容不足或不正確者, 將被要求重新繳交; 若未補交者, 則視為缺交測試報告處理
4. 需延長量測時間者, 請在收到晶片後 2 星期內提出延長量測時間申請